



## NEWS RELEASE

報道資料

2009年12月22日

(日本時間)

### アプライド マテリアルズ セミツール株式の公開買付 94%強の応募株式数で完了

アプライド マテリアルズ (Applied Materials, Inc., Nasdaq : AMAT、本社 : 米国カリフォルニア州サンタクララ、会長兼 CEO マイケル・スプリンター) は 12 月 18 日 (現地時間)、米セミツール (Semitool, Inc.) の発行済全株式に対する 1 株当たり 11.00 ドルでの現金公開買付を完了したことを発表しました。公開買付は 2009 年 12 月 17 日 (東部標準時) の深夜 12 時に終了しています。アプライド マテリアルズは合併の第 2 段階を実施し、セミツールの買収を 2009 年 12 月 21 日までに完了する予定です。アプライド マテリアルズはこの買収により、成長著しいウエーハパッケージング分野における新規顧客獲得の機会を増やし、先進的な半導体製造を補完する装置ならびに技術を提供していきます。

アプライド マテリアルズのシニアバイスプレジデント兼ジェネラルマネージャー (シリコンシステムズグループ)、ランディア・タッカーは次のように述べています。「セミツールはアプライド マテリアルズの戦略と合致し、この合併によって半導体業界の 2 つの重要な高成長市場への対応が強化されます。その結果、製品ラインアップがさらに充実し、半導体製造とパッケージングの両方に適合した広範な製造ソリューションをお客様に提供できるため、よりパワフルでコスト効率の高い先進的なデバイスへの需要拡大にも対応できます」

本公開買付の受託機関から提供された暫定的な情報によれば、2009 年 12 月 17 日の営業終了時点までに寄せられた有効な応募株式数は、セミツールの発行済普通株式の 94%強にあたる 31,222,684 株でした (公開買付の終了前に撤回されたものを除く)。これら全株式は、本公開買付の条件に則った支払いの対象として受領され、その中には引渡保証 (guaranteed delivery) 規定を適用して応募された 1,462,914 株も含まれています。

すでに 2009 年 11 月 17 日に発表したとおり、アプライド マテリアルズとその 100%子会社ジュピターアクイジションサブ (Jupiter Acquisition Sub, Inc.) およびセミツールは、ジュピターアクイジションサブが本公開買付の条件に従ってセミツールの発行済普通株式全数を 1 株当たり現金 11.00 ドル (利息なし、適用される源泉徴収税があればこれを差し引いた額が応募株主に支払われる) で買い付けることを趣旨とした合併合意を結んでいま

す。アプライド マテリアルズはこの合併合意に基づき、公開買付に応募されなかったセミツール株（アプライド マテリアルズとセミツールが保有する株式、およびモンタナ州法に基づき適正に反対権を行使する株主が保有する株式を除く）を、合併の第 2 段階として公開買付価格と同じ 1 株当たり 11.00 ドルで取得します。アプライド マテリアルズは、合併を 2009 年 12 月 21 日までに完了させたい意向です。合併完了後、セミツールはアプライド マテリアルズのシリコンシステムズグループのビジネスユニットとして運営されます。

#### 将来予測の記述に関する注意事項

本プレスリリースには、アプライド マテリアルズが予定しているセミツールの買収およびこの取引から予想される利点に関する将来の見通しが述べられています。こうした記述は既知または未知のリスクや不確定要素に左右されるため、実際の結果はこうした記述が明示ないし暗示する帰結と大きく異なる場合があります。このようなリスクや不確定要素としては、①すべての締結条件が満たされないため買収が適時に成立しない、あるいは不調に終わるリスク、②買収した事業の統合の成否と業績、③未知、未開示ないし過小評価されているコミットメントや負債の存在、④アプライド マテリアルズの製品への需要水準（グローバルな経済・業界動向の不確実性、エレクトロニクス製品や半導体への需要、顧客企業の工場稼働率と新技術および生産設備へのニーズなど多くの要因の影響を受ける）、⑤当社が(i)買収から期待されるシナジー効果を実現する能力、(ii)広範な製品を開発・提供・サポートして市場を拡大したり新規市場を開拓する能力、(iii)主要技術に関する知的財産権を取得ならびに保護する能力、(iv)主力となる社員を採用し、そのモチベーションを高めて定着させる能力、⑥その他、当社が証券取引委員会（SEC）に提出する書類に記載しているリスクなどがあります。将来の見通しに関する記述はすべて本リリースの発表時点における経営陣の推定、予測、仮定に基づくものです。アプライド マテリアルズは将来の見通しに関する記述を更新する義務を負っておりません。

アプライド マテリアルズは、半導体チップ、フラットパネル、太陽電池、フレキシブルエレクトロニクス、省エネガラスの製造におけるイノベティブな装置、サービスおよびソフトウェア製品を幅広く提供する **Nanomanufacturing Technology™** ソリューションのグローバルリーダーです。アプライド マテリアルズは、人々のライフスタイルを向上させるナノマニュファクチャリングテクノロジーを提供します。

詳しい情報はホームページ：<http://www.appliedmaterials.com> でもご覧いただけます。

\*\*\*\*\*  
このリリースは 12 月 18 日米国においてアプライド マテリアルズが行った英文プレスリリースをアプライド  
マテリアルズ ジャパン株式会社が翻訳の上、発表するものです。

アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社(本社:東京都、代表取締役社長:渡辺徹)は 1979 年 10 月  
に設立。大阪支店ほか 12 のサービスセンターを置き、日本の顧客へのサポート体制を整えています。

このリリースに関する詳しいお問い合わせは下記へ  
投資家関係:

Applied Materials, Inc.

インベスターリレーションズ: 矢野 悦子 (Tel: +1-408-986-2646)

etsuko\_joslen@amat.com

メディア関係:

アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社

社長室: 大橋 百合 (Tel: 03-6812-6801)

ホームページ: <http://www.appliedmaterials.com>

---